

证券代码：688720

证券简称：艾森股份

江苏艾森半导体材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-010

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	线上参与公司 2024 年半年度业绩说明会的全体投资者： 诺安基金、禹田资本、广发基金、中再资产管理、交银施罗德基金、建信基金、博时基金、南方基金、华能贵诚信托、长信基金、华宝基金、和谐健康险、多和美、尚诚资产、人保资产、景泰利丰、大家资产、和聚投资、中信另类、中银资管、博道基金、兴业基金、衍航投资、中科沃土基金、承珞资本、恒越基金、上海人寿、金信基金、长城财富、信达资本、红石榴、上海保银投资、粤信资产、中信股衍、益菁汇资产、路博迈（上海）、Pleiad Investment Advisors、Polymer Capital、中信固收、聆泽投资、星元投资、红杉资本、正圆投资、和基投资、宏鼎财富、Brilliance、第五公理、仙人掌资产、海金投资、昊泽致远、新活力资本、辰星投资、狐尾松资产、闻天投资、东吴基金、华能贵诚信托、华安证券、深圳前海旭鑫资产、上海骐邦投资、粤佛基金、海富通基金、中泰电子、元诚基金、耕霖投资、申银万国、平安银行、长盛基金、华金电子、长安基金、西南证券、贵山基金、凯丰投资、兴业基金、华泰保兴基金、苏州国发、海通证券、山西证券、平安基金
时间	2024 年 8 月 19 日-2024 年 8 月 20 日

地点	线上及网络互动
上市公司 接待人员姓名	<p>董事长：张兵</p> <p>常务副总经理、董事会秘书：陈小华</p> <p>财务总监：吕敏</p> <p>独立董事：李挺</p> <p>证券事务代表：徐雯</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司管理层介绍 2024 年半年度经营情况</p> <p>1、公司整体经营情况：2024 年上半年度，公司实现营业收入 1.86 亿元，同比增长 20.63%，归母净利润 1,373.95 万元，同比增长 23.57%。增长的主要原因是，国内半导体行业总体呈现出复苏趋势，下游厂商的需求回暖，同时公司在先进封装领域的销售收入持续提高。</p> <p>2、主营业务分产品的情况：公司产品主要聚焦在电镀液及配套试剂、光刻胶及配套试剂两大产品板块，2024 年上半年度，公司电镀液及配套试剂收入 8,345.30 万元，同比增长 13.31%，占总营业收入的 46%左右，光刻胶及配套试剂收入 4,082.97 万元，同比增长 44.57%，占比 23%左右，电镀配套材料收入 5,531.25 万元，同比增长 24.09%，占比 30%左右。</p> <p>3、公司产品进展情况：</p> <p> 电镀液及配套试剂方面，主要聚焦晶圆 7-28nm、先进封装等先进制程。先进封装领域，电镀锡银添加剂取得客户的小批量订单；先进封装电镀铜添加剂，电镀铜基液，处于稳定性验证阶段；在晶圆领域，公司 28nm 大马士革镀铜添加剂产品在中试阶段，14nm 以下制程的超纯硫酸钴产品在客户验证阶段，晶圆制造铜制程用清洗液，实现小批量供应。</p> <p> 光刻胶及配套试剂方面，公司光刻胶产品覆盖晶圆制造、先进封装和半导体显示等应用领域：在晶圆制造领域，公司的 i 线光刻胶已经在晶圆厂小量产，PSPI 光刻胶目前在主力晶圆厂验证测试中。在先进封装领域，公司的先进封装负性光刻胶已经在长电科技、华天科技等主要封装厂实现量产，目前处于量产放大阶段。半导体显示领域，公司 OLED 光刻胶（全膜层）目前在京东方验证中。公司先进封装光刻胶配套试剂是国内先进封装厂的主力供应商之一。</p>

二、问答交流环节

问题一：公司在研发方面有取得什么突破？

回答：电镀液及配套试剂方面，公司在持续夯实传统封装国内龙头地位的基础上，逐步在先进封装以及晶圆 28nm、14nm 先进制程取得突破。①在先进封装领域，公司先进封装用电镀锡银添加剂已通过长电科技的认证并取得小批量订单；先进封装用电镀铜基液（高纯硫酸铜）已在华天科技正式供应；先进封装用电镀铜添加剂处于批次稳定性验证。②在晶圆领域，公司 28nm 大马士革铜互连工艺镀铜添加剂产品已进入样品试制和产品认证阶段；14nm 先进制程的超高纯硫酸钴已完成样品生产，在客户端测试进展顺利；晶圆制造铜制程用清洗液已完成客户测试认证，实现小批量交付。

光刻胶及配套试剂方面，先进封装负性光刻胶已通过长电科技、华天科技的认证并实现批量供应；OLED 光刻胶（应用于两膜层）及晶圆制造 i 线正性光刻胶已分别通过京东方及华虹宏力的认证并开始小批量供应。公司是国内先进封装光刻胶配套试剂产品主力供应商，主要产品包括附着力促进剂、显影液、蚀刻液、去除剂等。

问题二：报告期内公司研发费用同比增长 54.81%，这些研发资金主要投向了哪些创新项目？预计会为公司带来哪些长期收益？

回答：公司研发主要投入在先进封装及晶圆制造领域电镀液和光刻胶等产品，主要产品包括：晶圆制造 14nm 制程超纯硫酸钴、28nm 制程大马士革电镀铜添加剂、功率器件用 PSPI 光刻胶；先进封装用电镀铜添加剂、电镀锡银添加剂等。

问题三：领导好，公司目前在电镀液及配套试剂方面技术储备如何？

回答：公司通过持续的技术创新和工艺创新，实现核心技术的持续迭代，以满足客户日益增长的高端功能需求。在电镀液及配套试剂方面，公司在 7-14nm 制程的电镀钴及添加剂，28-90nm 制程的电镀铜及添加剂，先进封装电镀锡银添加剂等方面均进行了积极的技术储备。

问题四：公司 24 年上半年营业收入同比增长 20.63%，主要得益于哪些业务板块？

回答：公司 2024 年上半年营业收入 1.86 亿元，同比增长 20.63%，主要

	<p>得益于公司电镀液、光刻胶及配套试剂销售收入的增长，其中电镀液及配套试剂销售收入同比增长 13.31%，光刻胶及配套试剂销售收入同比增长 44.57%，公司在先进封装领域的销售收入持续提高，营业收入表现出良好的增长趋势。</p> <p>问题五：请问公司在光刻胶及配套试剂方面有什么创新产品吗</p> <p>回答：在光刻胶及配套试剂方面，公司光刻胶产品覆盖晶圆制造、先进封装和半导体显示等应用领域：（1）在晶圆制造领域，公司的 i 线光刻胶已经在晶圆厂小量产，PSP1 光刻胶目前在主力晶圆厂验证测试中。</p> <p>（2）在先进封装领域，公司的先进封装负性光刻胶已经在长电科技、华天科技等主要封装厂实现量产，目前处于量产放大阶段。（3）半导体显示领域，公司 OLED 光刻胶（全膜层）目前在京东方验证中。（4）公司先进封装光刻胶配套试剂是国内先进封装厂的主力供应商之一。</p> <p>问题六：公司目前经营性现金流情况如何？其他关键财务指标是否有所改善？</p> <p>回答：公司目前现金流情况良好，公司上半年经营活动产生的现金流量净额为负，主系公司票据收款贴现的现金流入计入“筹资活动产生的现金流量-取得借款收到的现金”所致。2024 年上半年，公司经营活动现金净流出较上年同期有所下降，主要系公司票据贴现减少，承兑到期现金流入增加所致。</p>
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	无
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 8 月 20 日